2-1-2-21 SR 表面糊状異物付着/SR 表面附着粘性杂物/ Pasty foreign object on solder resist surface

【特徴】SR表面に糊や粘土状の異物が付着してい る状態の欠陥

【特征】SR 表面附着胶或者粘性杂物的缺陷

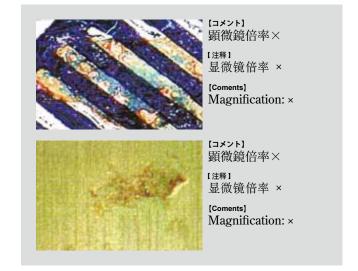
[Characteristics] A pasty or clay-like foreign object is adhered on the solder resist surface.

【原因・判断ポイント・発生工程】SR表面に糊状 または粘土状の異物が付着して出来たもの(SR塗 布乾燥後工程)

【原因、判断要点、发生工序】SR 表面附着胶或者粘 性杂物而造成的(SR 烘干后工序)。

[Causes/processes involved/keys to judgment]

The defect is caused by a pasty or clay-like foreign object adhered on the solder resist surface. (After solder resist application process)



2-1-2-22 SR 面テープ残り/ SR 表面附着胶带屑/ Tape left on solder resist surface

【特徴】識別マークテープやラベル、セロテープな どがSR表面に付着したままになっている状態の欠

【特征】在 SR 表面附着识别胶带、标签、透明胶带 等屑的缺陷。

[Characteristics] An identification mark tape, a label, cellulose tape or the like is left attached on the solder resist surface.

【原因・判断ポイント・発生工程】 識別マークテープやラベル、セロテープ等の屑が誤って転写付着し たり、除去忘れや除去残りなどにより出来たもの(S R塗布乾燥後工程)

【原因、判断要点、发生工序】错误地让识别胶带, 标签、透明胶带等的屑转移,或者忘记擦掉、擦不干 净而造成的(SR 烘干后工序)。

[Causes/processes involved/keys to judgment]

A debris of an identification mark tape, a label, cellulose tape or the like is transferred and attached to by mistake, and left unremoved or incompletely removed on the solder resist surface. (After solder resist application process)

